

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen

Teil 6-8: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen
von SMD-Halbleitergehäusen –
Konstruktionsleitfaden für Glas-Keramik-Quad-Flatpack (G-QFP)
(IEC 60191-6-8:2001) Deutsche Fassung EN 60191-6-8:2001

DIN**EN 60191-6-8**

ICS 01.100.25; 31.240

Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 6-8: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages –
Design guide for glass sealed ceramic quad flatpack (G-QFP)
(IEC 60191-6-8:2001);
German version EN 60191-6-8:2001

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –
Partie 6-8: Règles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs à montage en surface –
Guide de conception pour les boîtiers plats quadrangulaires
en céramique, scellement verre
(CEI 60191-6-8:2001);
Version allemande EN 60191-6-8:2001

Die Europäische Norm EN 60191-6-8:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.**Beginn der Gültigkeit**

EN 60191-6-8 wurde am 2001-10-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 „Gehäuse für Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 47D/131/CD:1996-11.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2005 unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Fortsetzung Seite 2
und 12 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Nationaler Anhang NA (informativ) Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
Normen der Reihe EN 60191	Normen der Reihe IEC 60191	Normen der Reihe DIN EN 60191	–

Nationaler Anhang NB (informativ) Literaturhinweis

DIN EN 60191, *Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen*.

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen
Teil 6-8: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen
von SMD-Halbleitergehäusen –
Konstruktionsleitfaden für Glas-Keramik-Quad-Flatpack (G-QFP)
(IEC 60191-6-8:2001)

Mechanical standardization
of semiconductor devices
Part 6-8: General rules for the preparation of outline
drawings of surface mounted
semiconductor device packages –
Design guide for glass sealed ceramic
quad flatpack (G-QFP)
(IEC 60191-6-8:2001)

Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs
Partie 6-8: Règles générales pour la
préparation des dessins d'encombrement
des dispositifs à semiconducteurs à montage
en surface –
Guide de conception pour les boîtiers plats
quadrangulaires en céramique, scellement verre
(CEI 60191-6-8:2001)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2001-10-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 47D/438/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60191-6-8, ausgearbeitet von dem SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ des IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-10-01 als EN 60191-6-8 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2002-07-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2004-10-01

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norm-Inhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-6-8:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Teil von IEC 60191 enthält die gemeinsamen Gehäusezeichnungen und Maße für alle Bauarten und zusammengesetzten Werkstoffe von Glas-Keramik-Quad-Flatpack-Bauelementen (nachfolgend mit G-QFP bezeichnet).

Der Zweck dieser Entwurfsrichtlinie ist, die Gehäusemaße zu normen und die Austauschbarkeit von G-QFP zu erreichen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teiles von IEC 60191 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teiles von IEC 60191 werden jedoch gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC führen Verzeichnisse der gültigen Internationalen Normen.

IEC 60191 (alle Teile), *Mechanical standardization of semiconductor devices*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Teils der IEC 60191 gelten die folgenden Begriffe zusammen mit denen, die in den anderen Teilen der vorliegenden Norm angegeben sind.

3.1

G-QFP

Gehäuse mit Glasdurchführungen und abgewinkelten Anschlüssen, die in vier Richtungen herausgeführt werden, um sie auf der Oberfläche einer Leiterplatte zu befestigen

4 Nummerierung der Anschlussstifte

Die Markierungsfläche ist an der oberen linken Ecke des Gehäusekörpers, wenn dieser von der Aufsetzebene aus betrachtet wird, angebracht. Der Anschluss, der am nächsten zur Markierungsecke liegt, erhält die Ziffer 1 und die nachfolgenden Anschlüsse, gezählt in Uhrzeigerrichtung, erhalten die Ziffern 2, 3 usw.